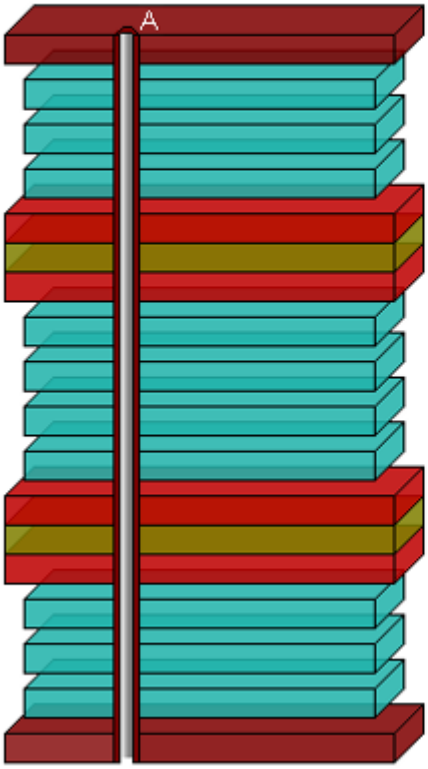
Dickkupfer-Multilayer 6 Lagen - 1,5/1,6 mm

Lagenaufbau

Ebene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
		Cu+galv.Cu		70+25	
1		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Cu		105	
2		Tr-Lam	0.20		
		Cu		105	
3		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Cu		105	
4		Tr-Lam	0.20		
		Cu		105	
5		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Prepreg	0.081		1080
		Cu+galv.Cu		70+25	
6					

Presslingsdicke*	1,53	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske*	1,64	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 gefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com

Dickkupfer-Multilayer 6 Lagen - 1,5/1,6 mm

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 350 µm
	Viapad-Ø	≥ 800 µm
Leiterbild Außenlagen		
	Leiterbreite bei 50 µm Grundkupfer	≥ 160 µm
	Leiterabstand bei 50 µm Grundkupfer	≥ 215 µm
Standard	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 200 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 260 µm
	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer	≥ 250 µm
	Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥ 320 µm
Leiterbild Innenlagen		
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 170 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 170 µm
Standard	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer	≥ 210 µm
	Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥ 220 µm

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com